

## 1.6

设半径为 $R$ 的圆形截面试件中通过微波振荡产生了均匀的热生成 $Q$ ,已知环境温度为 $T_h$ ,表面热交换系数为 $h$ ,导线的导热系数为 $k$ ,试求达成热平衡之后导线中心的温度 $C$ 。

对于该试件

$$H(T) = \rho C \frac{\partial T}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial x} \left( k \frac{\partial T}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial T}{\partial y} \right) - Q = 0$$

转化到极坐标下  $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$

$$\rho C \frac{\partial T}{\partial t} - \frac{k}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial T}{\partial r} \right) - \frac{k}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \frac{\partial T}{\partial \theta} \right) - Q = 0$$

边界条件  $T = T_1, k \frac{\partial T}{\partial r} = h(T_h - T_1)$

在稳态及轴对称条件下  $\frac{\partial T}{\partial t} = 0, \frac{\partial T}{\partial \theta} = 0$

则有

$$\frac{k}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial T}{\partial r} \right) = -Q$$

$$r \frac{\partial T}{\partial r} = -\frac{Q}{2k} r^2$$

$$T = C - \frac{Q}{4k} r^2$$

又

$$k \frac{\partial T}{\partial r} = h \left( T_h - C + \frac{Q}{4k} R^2 \right)$$

所以

$$C = \frac{Q}{4k} R^2 + \frac{Q}{2h} R + T_h$$

$$T = \frac{Q}{4k} R^2 + \frac{Q}{2h} R + T_h - \frac{Q}{4k} r^2$$

对于中心温度, 有 $r = 0$ , 则

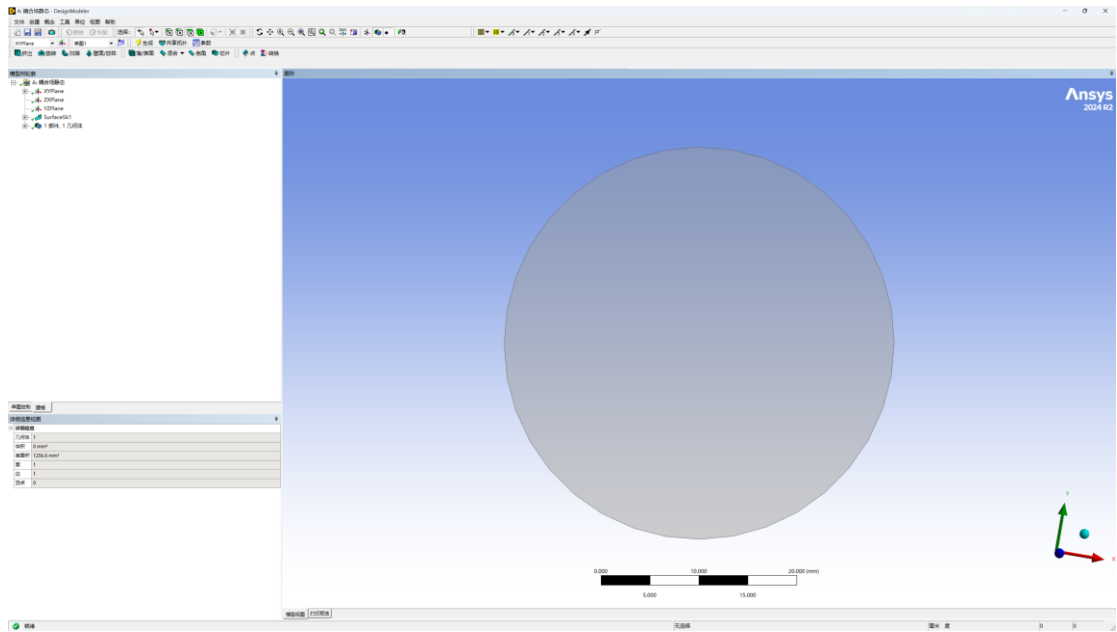
$$T_C = \frac{Q}{4k} R^2 + \frac{Q}{2h} R + T_h$$

## 7.1

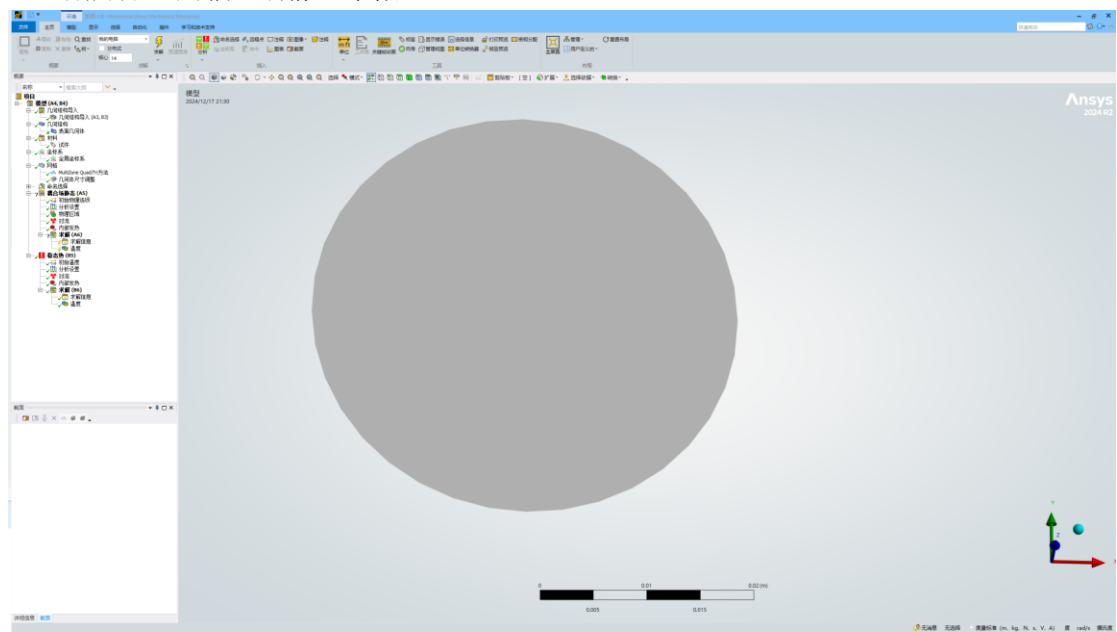
参照思考题 1.6, 已知 $R = 20\text{mm}$ ,  $Q = 10\text{mW} \cdot \text{mm}^{-3}$ ,  $T_h = 10^\circ\text{C}$ ,  $h = 20\text{mW} \cdot \text{mm}^{-2} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$ ,  $k = 200\text{mW} \cdot \text{mm}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$ , 试用有限元方法求达成热平衡之后导线中心的温度  $C$ , 并与理论值进行比较。

利用 Workbench 进行分析

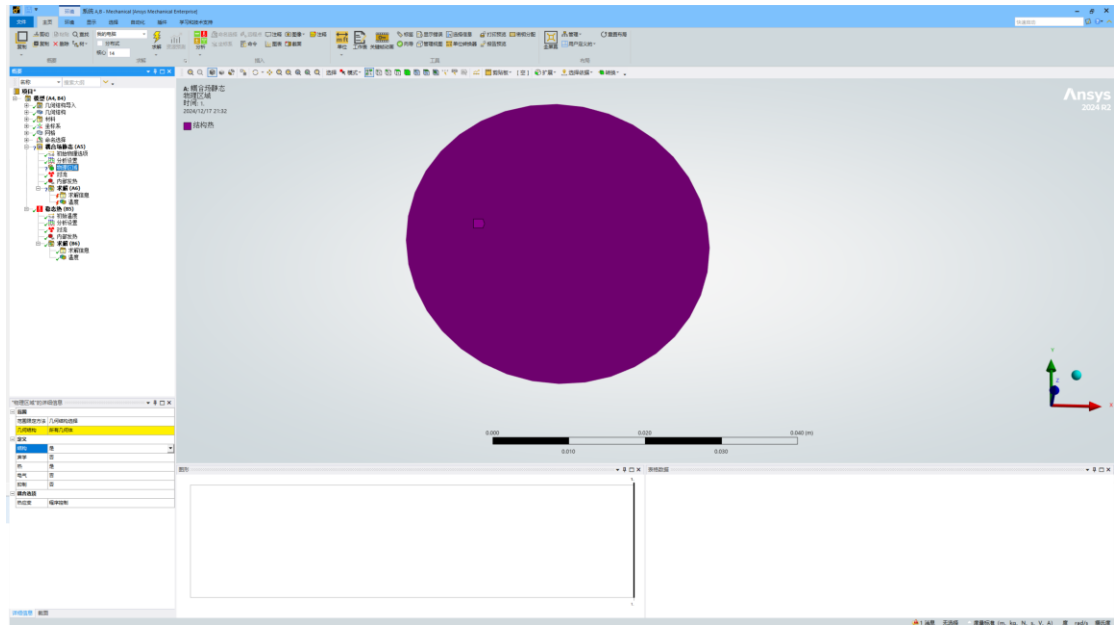
首先设置材料, 然后建立圆形平面



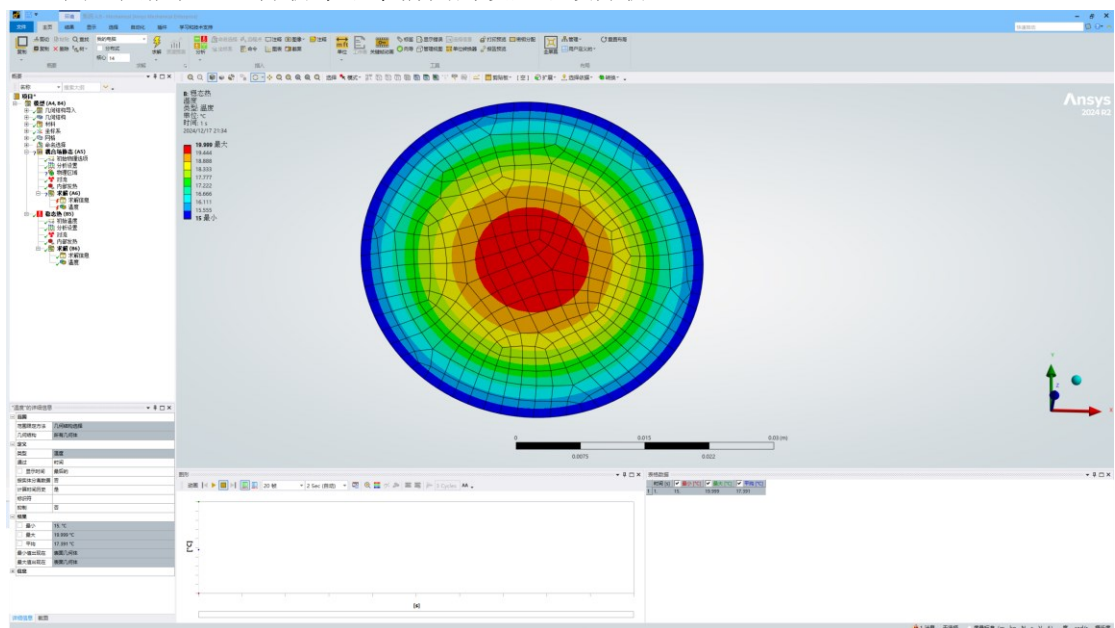
刚开始想用耦合场静态来做



模仿例题的步骤划分网络，加入对流和内部发热



发现如果同样用结构与热分析，无法选择一个平面作为几何体（例题中有两个平面）  
因此只能拖入热分析来继承前面的设置继续分析



热分析确实可行，给出了较为合理的热量分布图，中心最高温度为 19.999℃  
由 1.6 可知 C 的理论值为

$$C = \frac{Q}{4k} R^2 + \frac{Q}{2h} R + T_h = 20^\circ\text{C}$$

可以认为仿真结果与理论值相等

## 7.2

为什么在式（7.9）中采用了“ $\cong$ ”而不是“ $=$ ”？

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma_e} \mathbf{N}^T q^{(e)} dS &\cong \iint_{\Sigma_1} \mathbf{N}^T q_1 dS + \iint_{\Sigma_2} \mathbf{N}^T q_2 dS + \iint_{\Sigma_3} \mathbf{N}^T h T_3 - h T^{(e)} dS \\ &\cong -h \iint_{\Sigma_3} \mathbf{N}^T T^{(e)} dS + q_2 \iint_{\Sigma_2} \mathbf{N}^T dS + h T_3 \iint_{\Sigma_3} \mathbf{N}^T dS \end{aligned}$$

第一，由于内部表面总是成对出现在相邻的单元中，因而其上的热流密度积分，即热流在最后装配时会自动抵消，因而不须计算。此为上式第一处采用“ $\cong$ ”而不是“ $=$ ”的原因。

第二，对位于表面 $\Sigma_1$ 上的单元表面，无须计算，因为对于单元在这个表面上的结点，其对应的积分只对式(7.6)中的 $\mathbf{K}_c$ 产生贡献，而这个矩阵在求解 $\mathbf{T}_u$ 时用不到，因而不须计算；对于不在这个表面上的结点，则因其相应的形函数在这个表面上为 0，因而计算结果必为 0，无须计算。此为上式第二处采用“ $\cong$ ”的原因。